JCU CORPORATION

67期・2027年3月期
第2四半期決算説明資料

東証プライム　4975
2026年11月5日（木）

2027年3月期2Q　業績概況

【2Q 累計期間】　JCU（単体）⇒ 2026.4～2026.9
海外子会社　⇒ 2026.1～2026.6

薬品事業

電子分野

■中国はサーバー関連をはじめとする高機能電子デバイス向けプリント基板及び半導体パッケージ基板の需要が好調に推移し、薬品売上高は前年同期比で大幅に増加

■台湾はサーバー関連をはじめとする高機能電子デバイス向け半導体パッケージ基板の需要が好調に推移し、薬品売上高は前年同期比で増加

■韓国はメモリ需要の高まりにより半導体パッケージ基板需要の回復が継続し、薬品売上高は前年同期比で大幅に増加

装飾分野

■国内はデザイントレンドの変化に伴い薬品需要は低迷しておりましたが、当社が対象とする自動車部品の需要が増加したため、薬品売上高は前年同期比で増加

■中国は新エネルギー車優遇政策の変更によって中国内の需要が押し下げられたことで自動車の生産台数は減少したものの、当社が対象とする自動車部品の需要が増加したため、薬品売上高は前年同期比で増加

装置事業

■受注案件は予定通り進行いたしましたが、売上高は前年同期比で大幅に減少
一方、設備投資需要の増加により、受注高及び受注残高は大幅に増加

2027年3月期2Q　連結実績

(単位：百万円)

	2025年3月期 中間期	2026年3月期 中間期	2027年3月期 中間期		
	実績	実績	予想	実績	対前年増減率
売上高	12,736	14,258	15,700	15,875	11.3%
営業利益	4,665	5,781	5,900	5,866	1.5%
経常利益	4,983	5,780	6,000	6,101	5.6%
親会社株主に帰属する中間純利益	3,385	4,360	4,100	4,355	▲0.1%
1株当たり中間純利益	133円72銭	175円06銭	166円53銭	176円89銭	―

2027年3月期2Q　セグメント別連結実績

(単位：百万円)

		前年同期 (2026年3月期中間期)	2027年3月期 中間期	前年同期比	対前期増減率
薬品事業	売上高	12,501	14,613	2,112	16.9%
	セグメント利益	5,972	6,226	254	4.3%
	セグメント利益率	47.8%	42.6%	–	–
装置事業	売上高	1,757	1,262	▲495	▲28.2%
	セグメント利益	295	157	▲138	▲46.5%
	セグメント利益率	16.8%	12.5%	–	–
全社費用	営業損益	▲486	▲518	–	–

為替レート

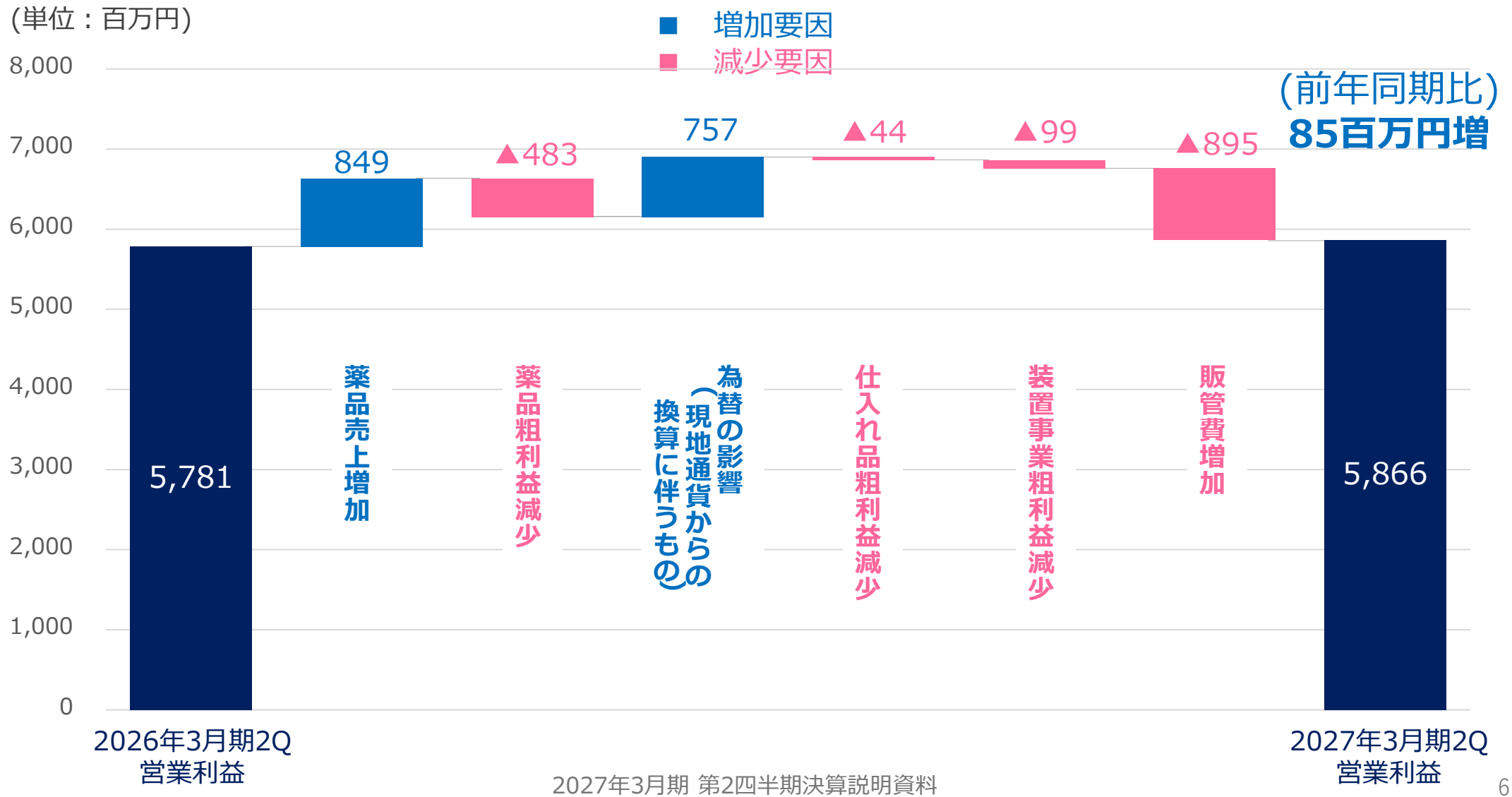
為替感応度（連結年換算）：下記主要通貨 1%の変動で、連結営業利益 1億円程度の影響

(単位：円)

	2026年3月期				2027年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q (期首予想)	2Q
中国人民元（ＣＮＹ）	20.94	20.47	20.51	20.82	22.66	23.05
台湾ドル（ＴＷＤ）	4.64	4.67	4.75	4.81	4.96	5.01
韓国ウォン（ＫＲＷ）	0.1052	0.1043	0.1050	0.1053	0.1071	0.1067

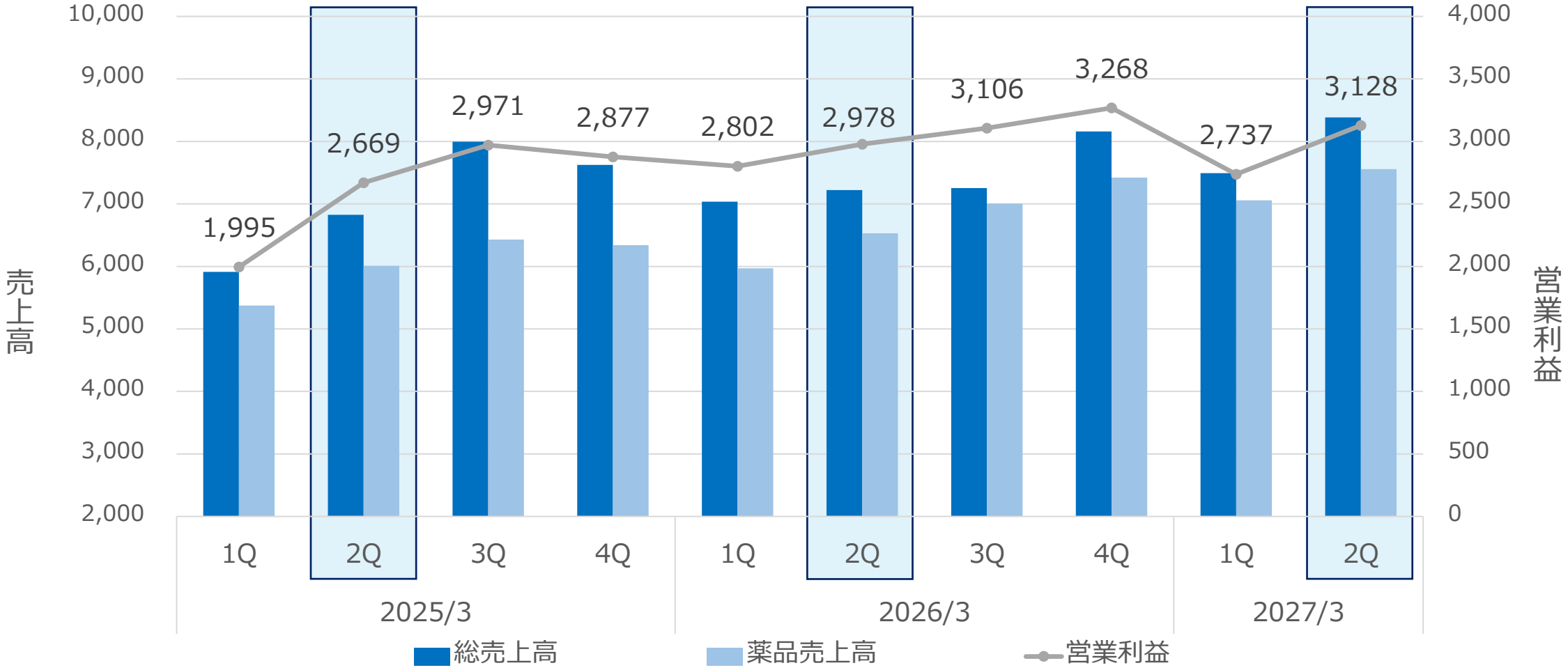
(注) 当社の主要な外国通貨は、中国人民元・台湾ドル・韓国ウォンであり、
いずれも、期中平均レートを採用しております。

2027年3月期2Q　連結営業利益　増減内容

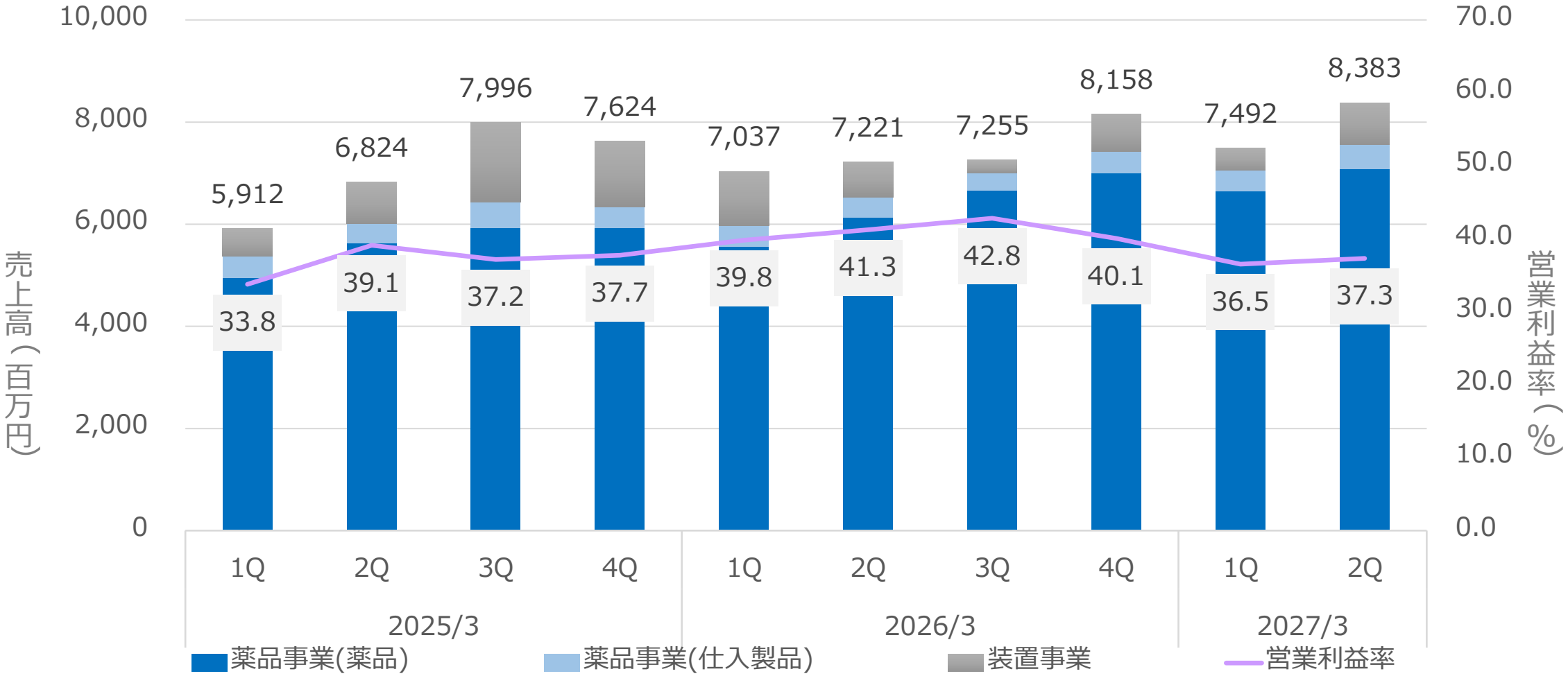


四半期別　連結実績の推移

(単位：百万円)

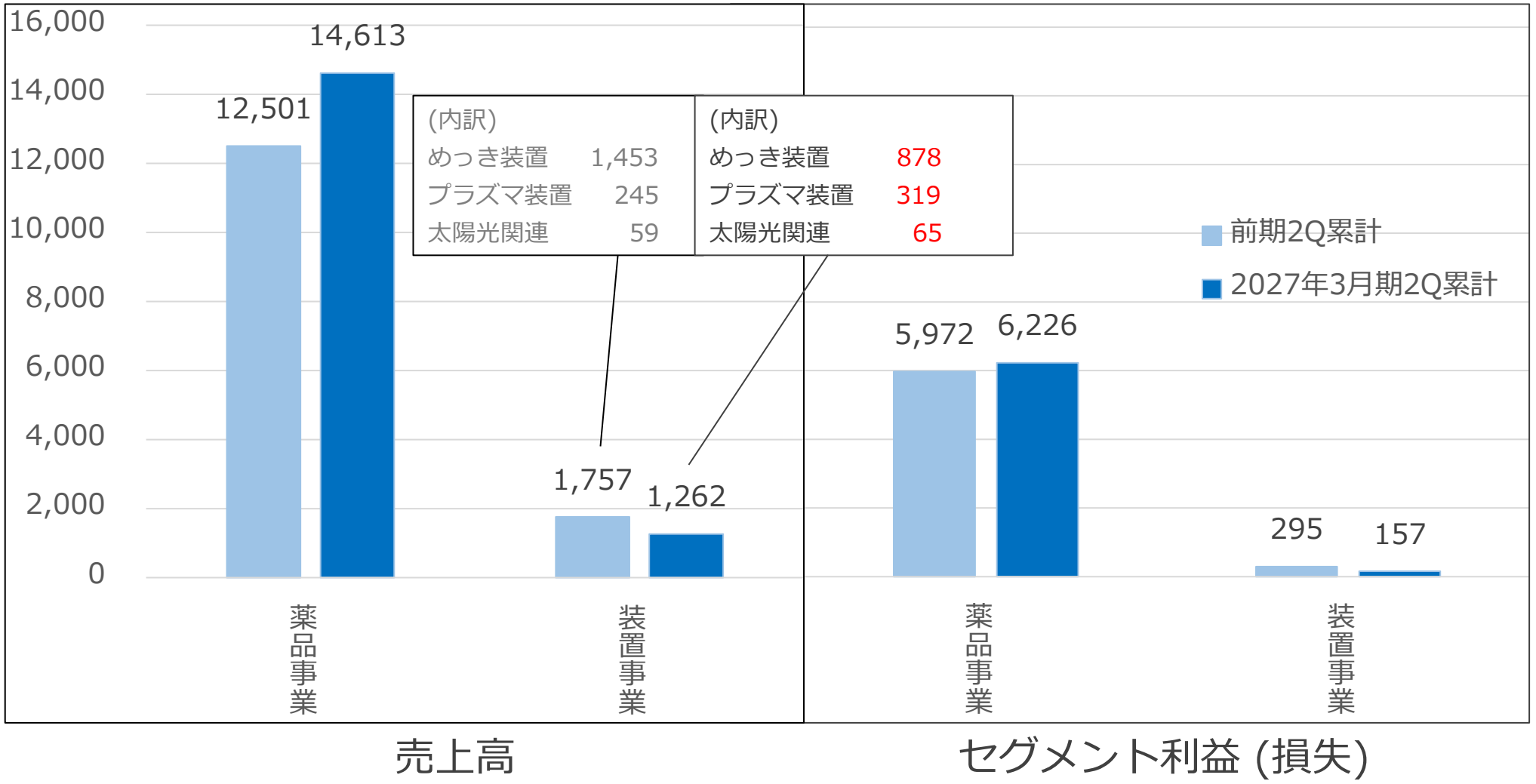


四半期別　連結業績の推移（セグメント別）



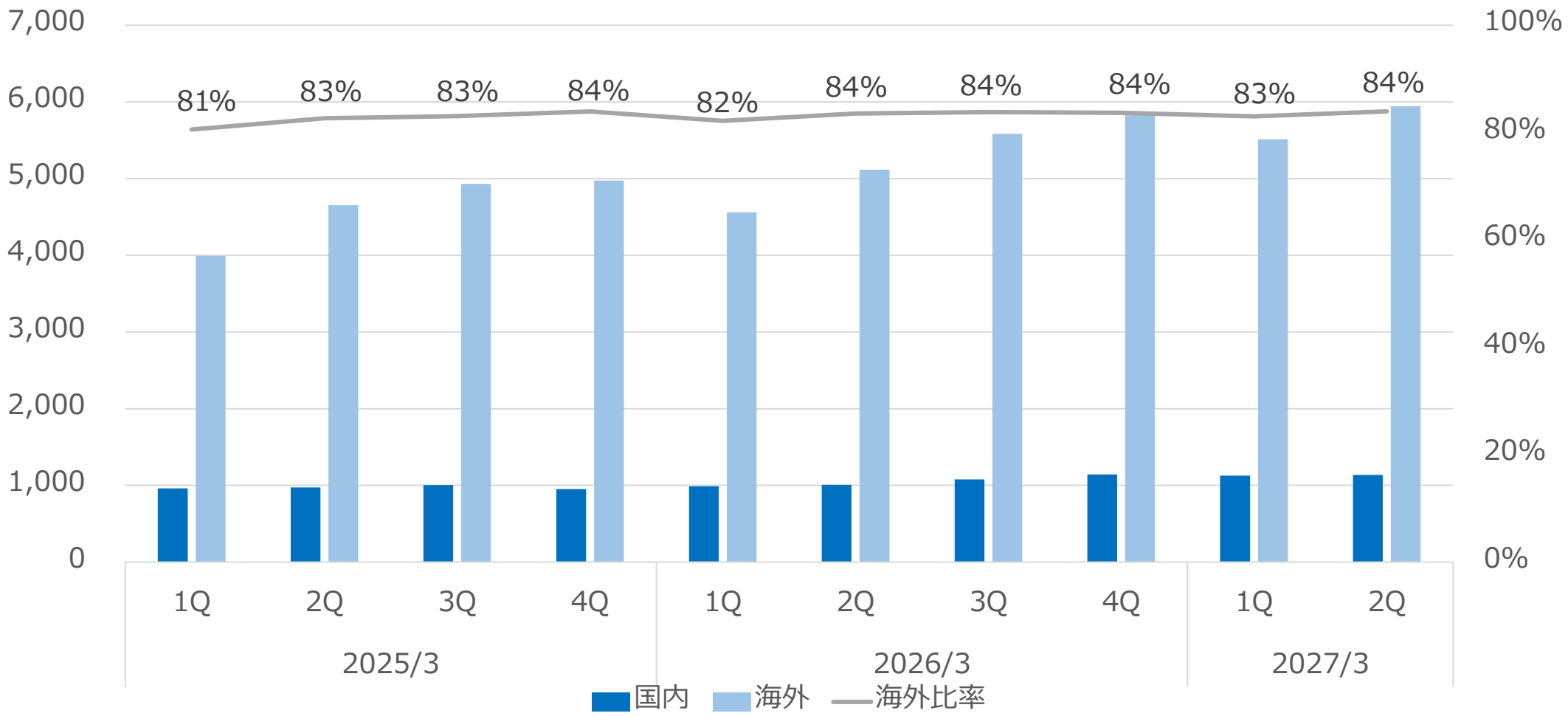
2027年3月期2Q　連結セグメント業績

(単位：百万円)



四半期別　国内外薬品売上高推移

(単位：百万円)

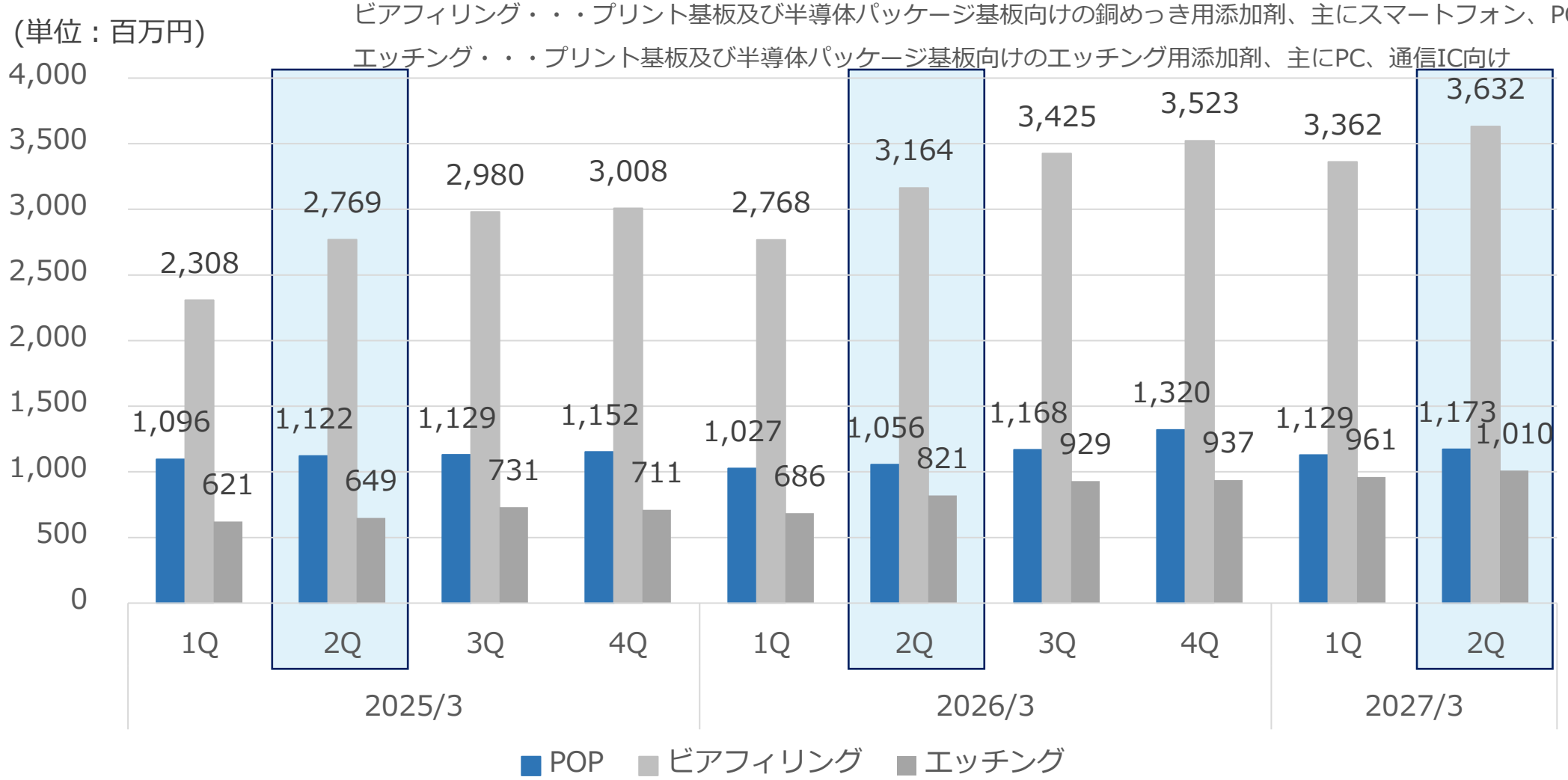


POP, ビアフィリング, エッチング用薬品｜四半期別 売上高推移

POP (Plating on Plastics) ・・・ プラスチック上へのめっきで、主に自動車部品向け

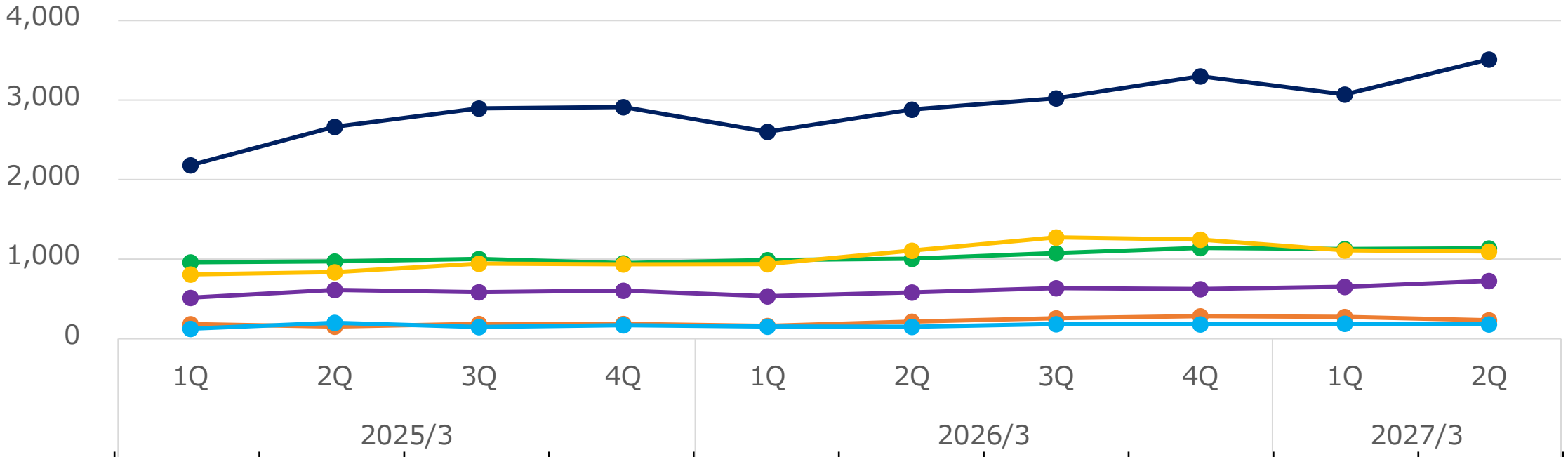
ビアフィリング・・・プリント基板及び半導体パッケージ基板向けの銅めっき用添加剤、主にスマートフォン、PC向け

エッチング・・・プリント基板及び半導体パッケージ基板向けのエッチング用添加剤、主にPC、通信IC向け



四半期別　地域別薬品売上高の推移

(単位：百万円)

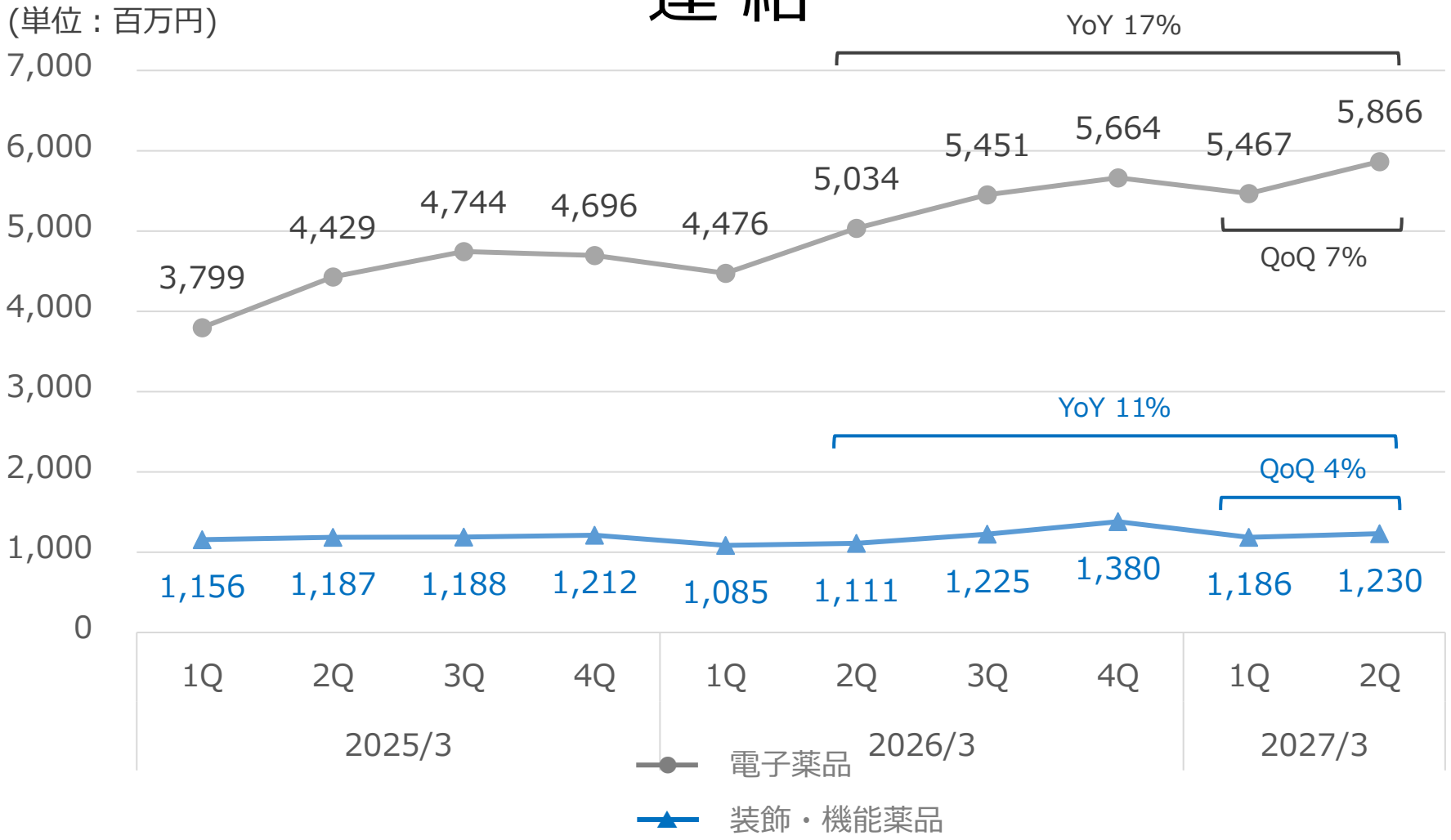


日本	962	974	1,005	950	989	1,007	1,078	1,142	1,128	1,137
中国	2,181	2,657	2,895	2,890	2,601	2,881	3,022	3,301	3,072	3,511
台湾	809	839	945	935	939	1,108	1,275	1,247	1,110	1,097
韓国	517	616	587	605	534	582	638	626	654	727
タイ	186	154	189	186	162	217	260	285	275	234
ベトナム	127	201	149	174	155	150	184	181	191	183

四半期別　地域別薬品売上高の推移

連 結

(単位：百万円)



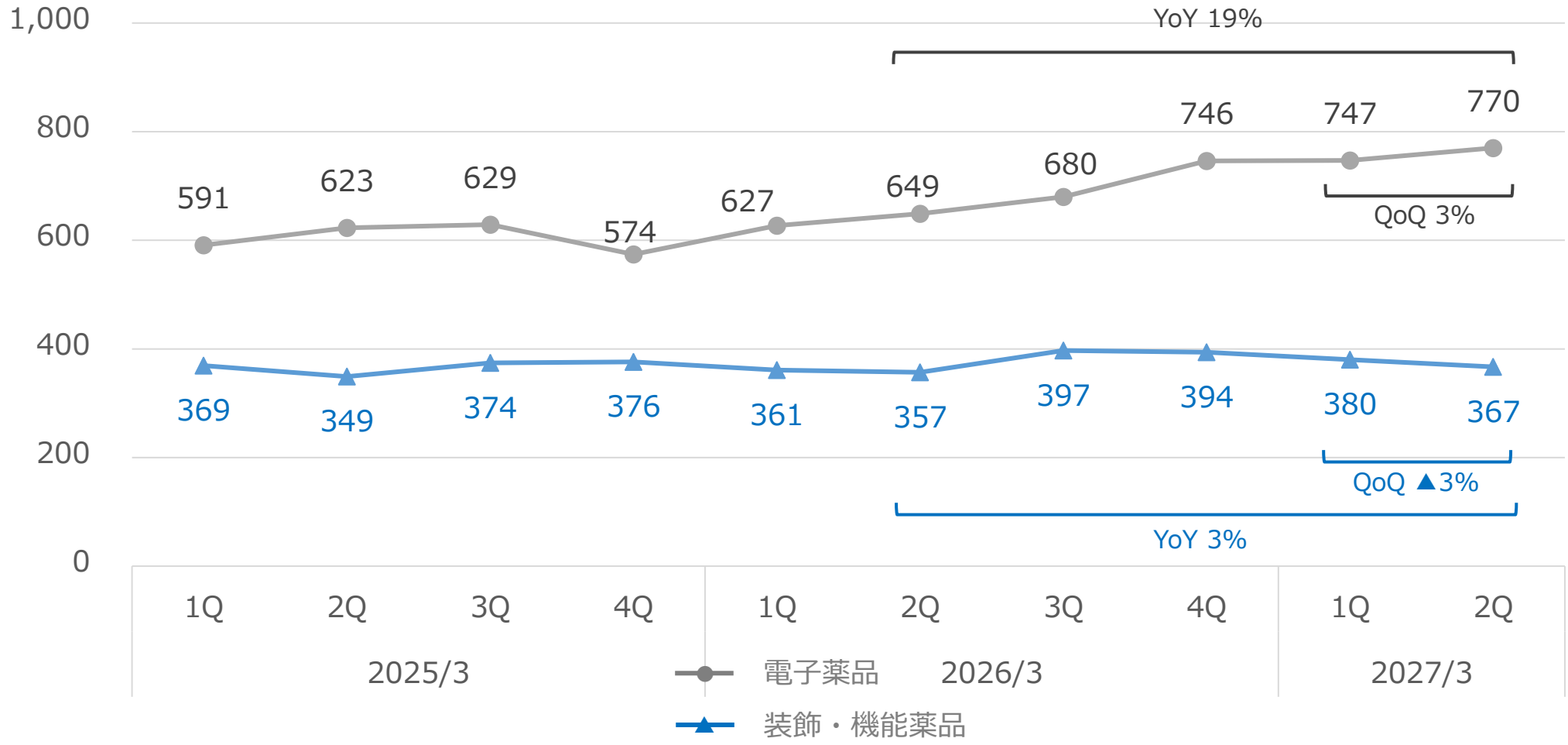
(電子薬品)　主力製品：ビアフィリング
プリント基板、コネクター、
半導体分野向けの表面処理(めっき)薬品

(装飾・機能薬品)　主力製品：POP
装飾、防錆分野向けの薬品
主に自動車部品、水栓金具等の
表面処理(めっき)薬品

四半期別　地域別薬品売上高の推移

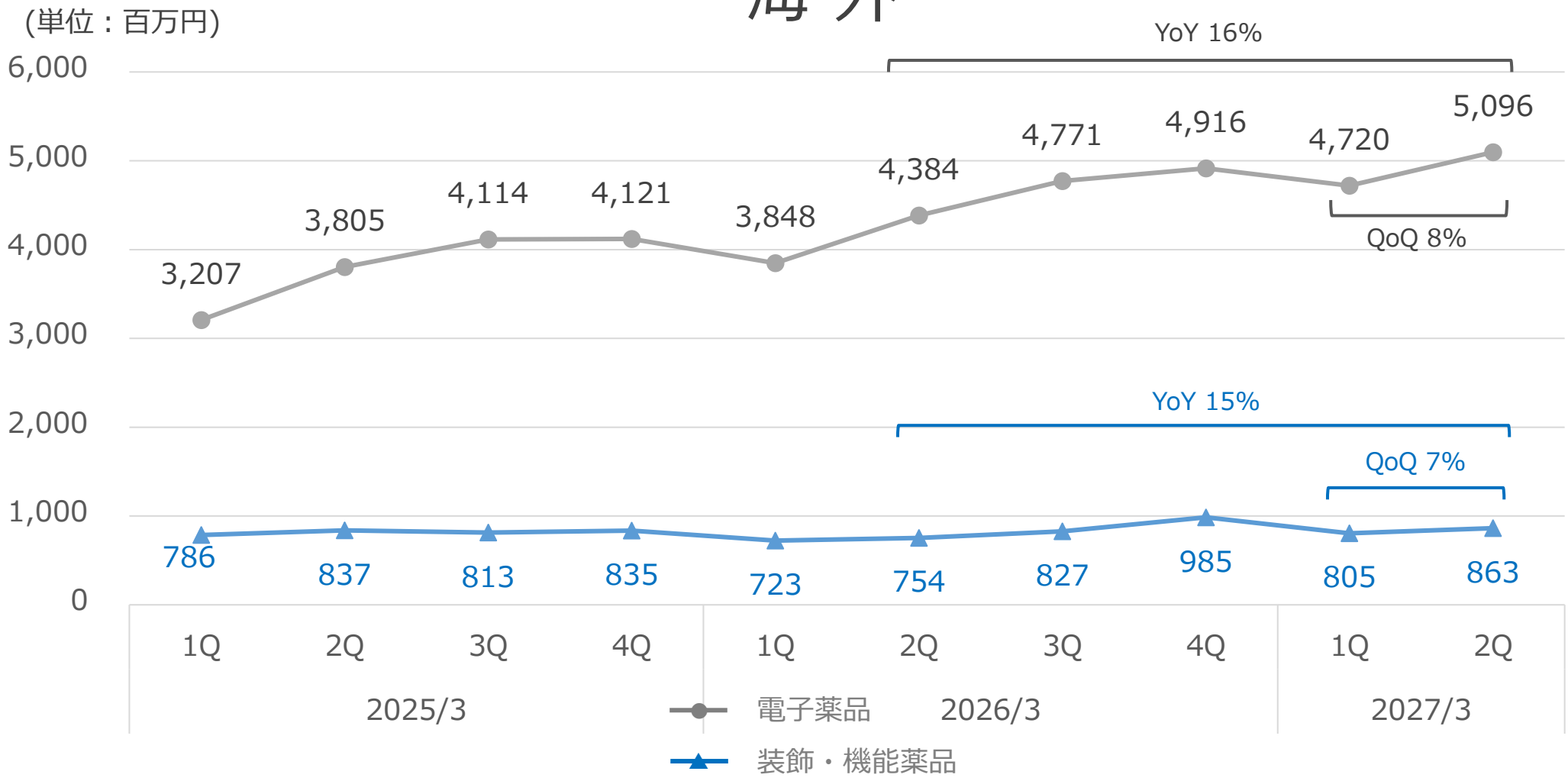
国 内

(単位：百万円)



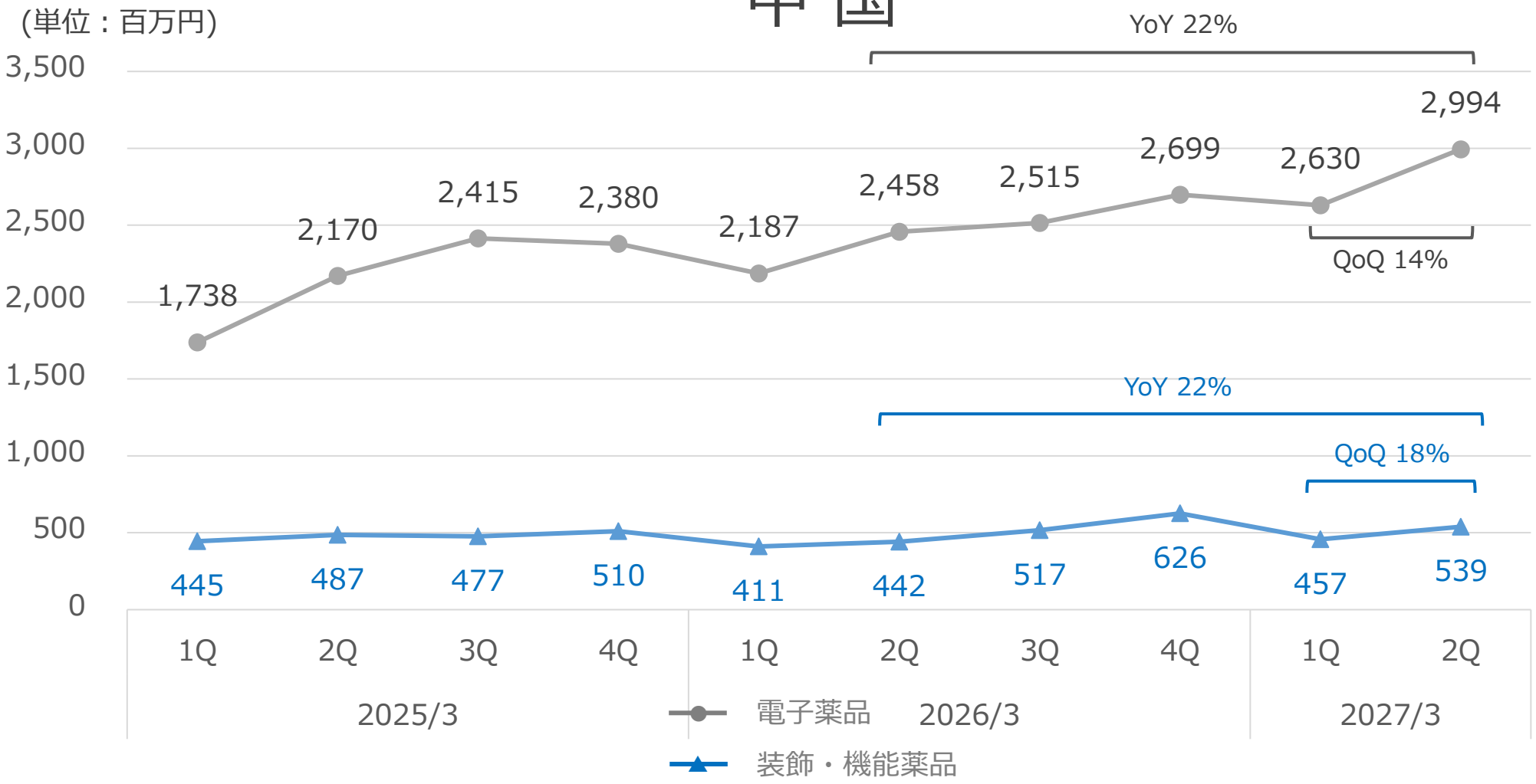
四半期別　地域別薬品売上高の推移

海 外



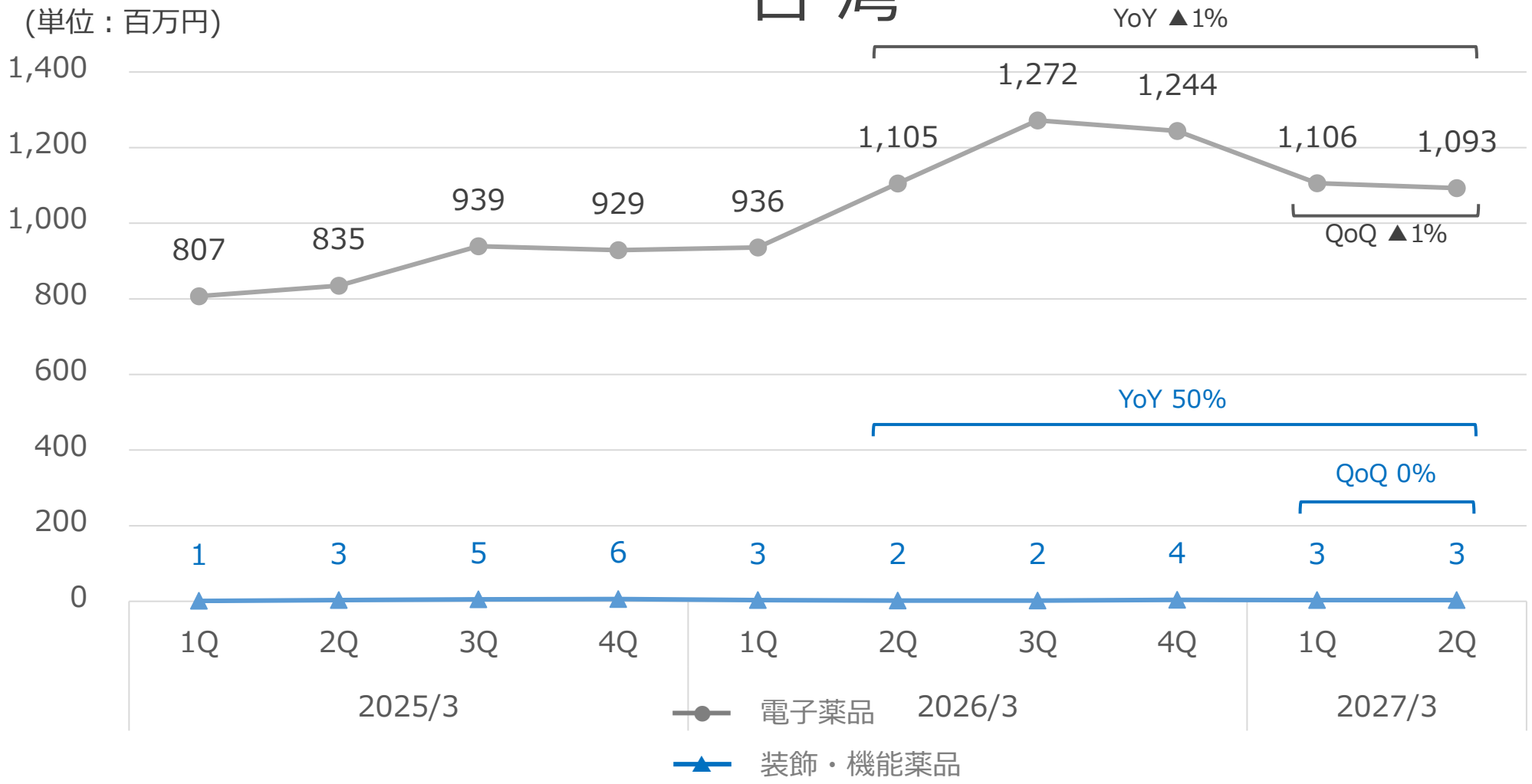
四半期別　地域別薬品売上高の推移

中 国

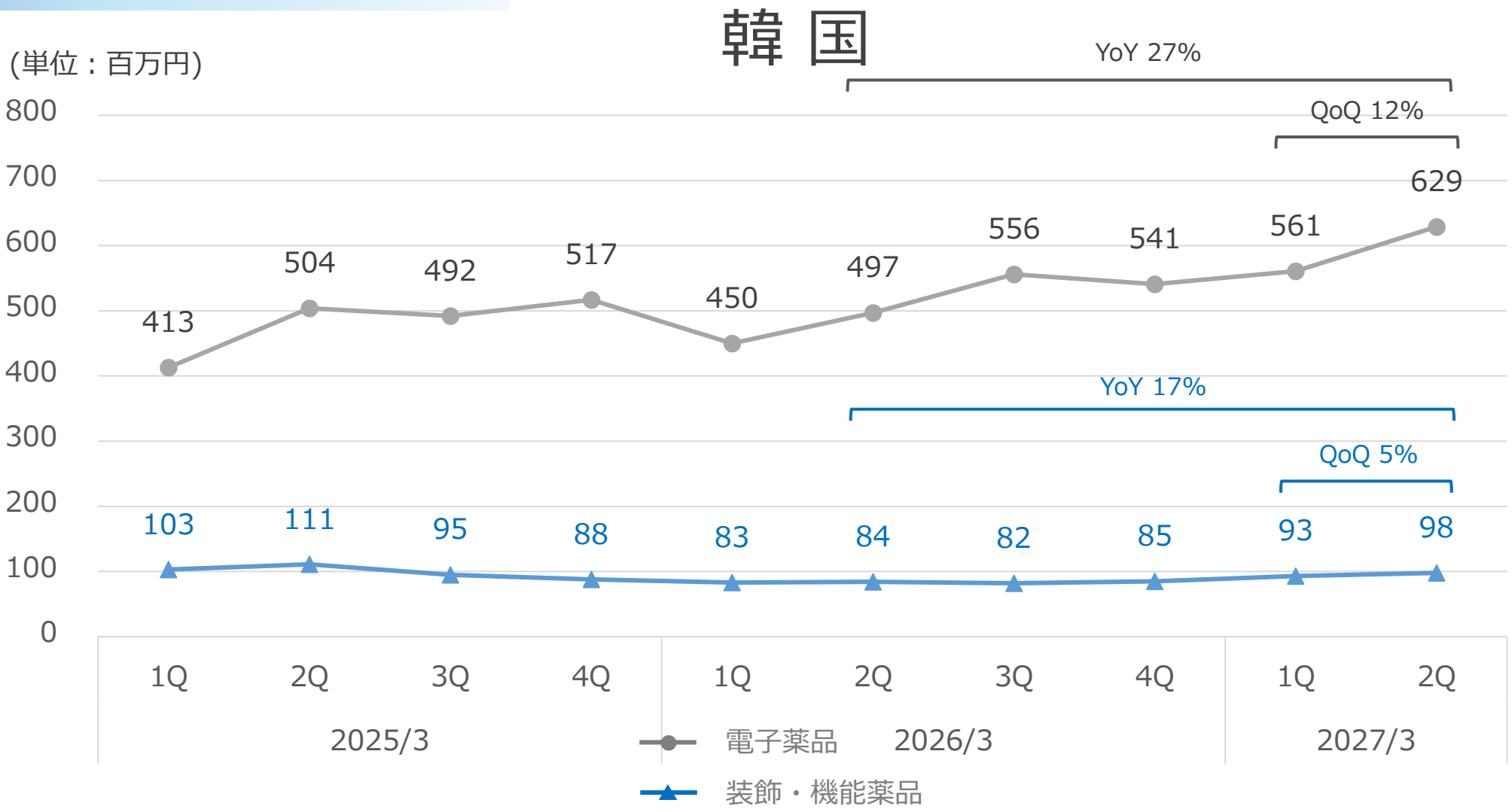


四半期別　地域別薬品売上高の推移

台 湾



四半期別　地域別薬品売上高の推移

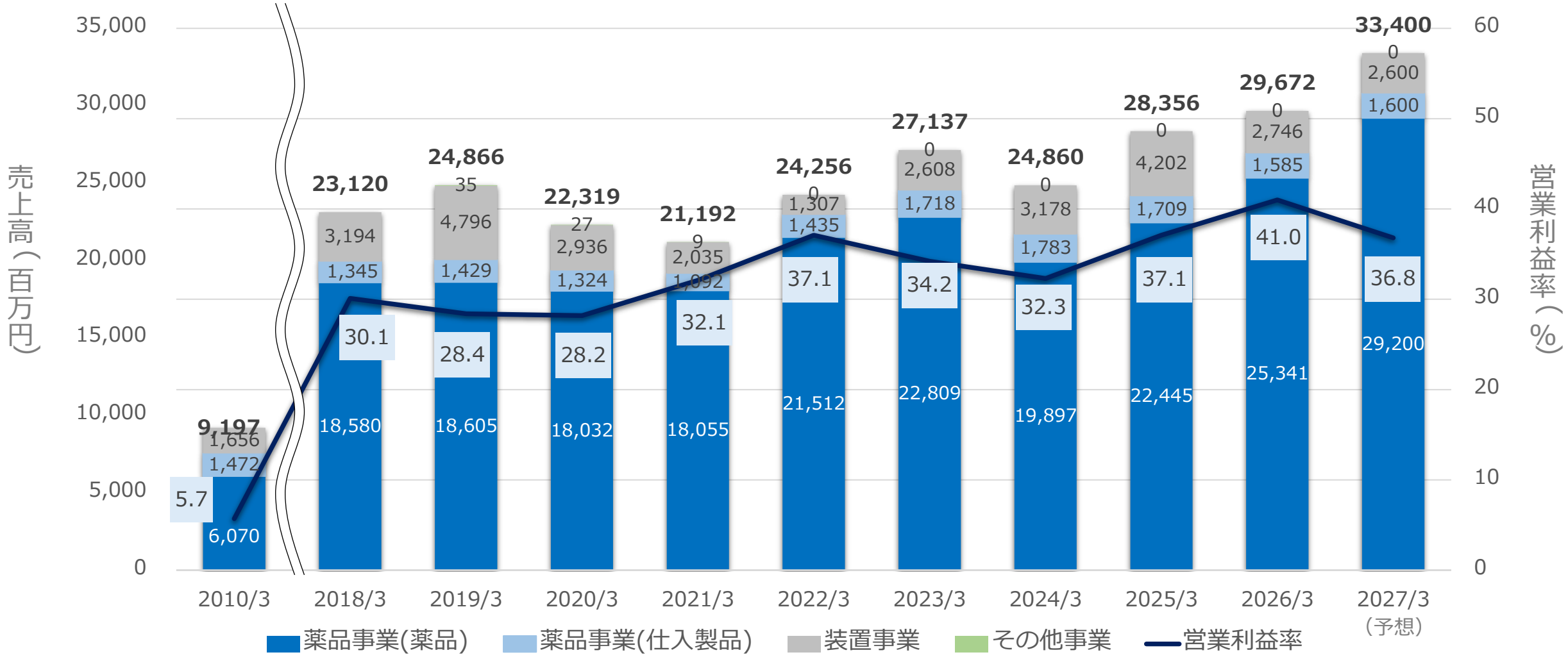


2027年3月期　業績予想

(単位：百万円)

決算期	2026年3月期 通期 実績	2027年3月期 中間期 実績	2027年3月期 通期 予想	通期予想に 対する進捗率
売上高	29,672	15,875	33,400	47.5%
営業利益	12,156	5,866	12,300	47.7%
経常利益	12,447	6,101	12,500	48.8%
親会社株主に帰属する中間純利益	9,074	4,355	8,800	49.5%
1株当たり中間純利益	365円74銭	176円89銭	357円39銭	―

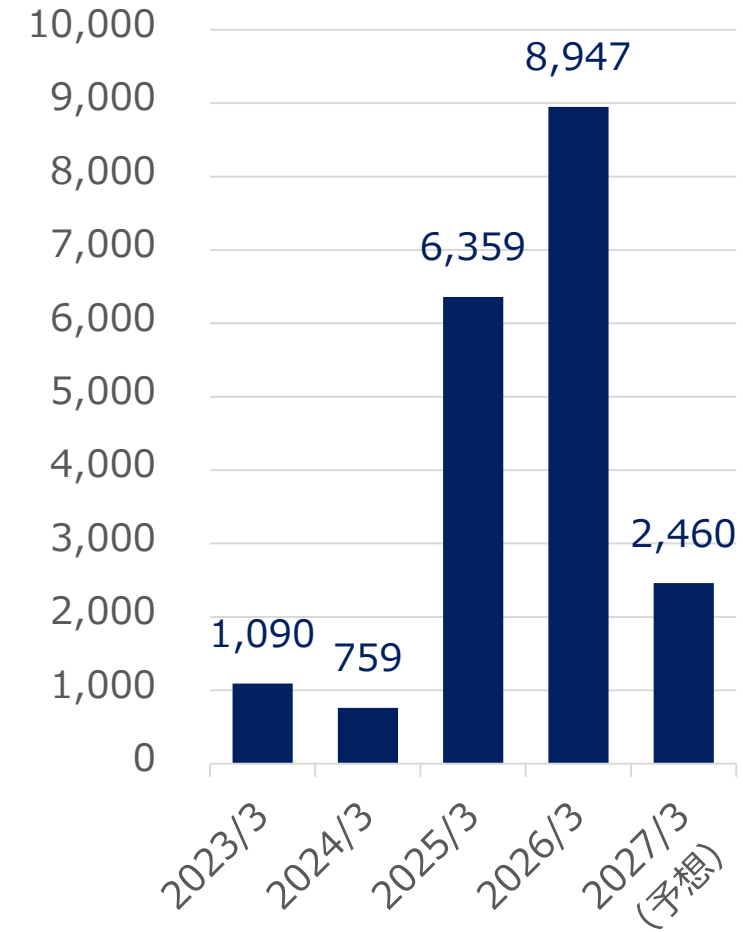
年度別セグメント別売上高推移（予想）



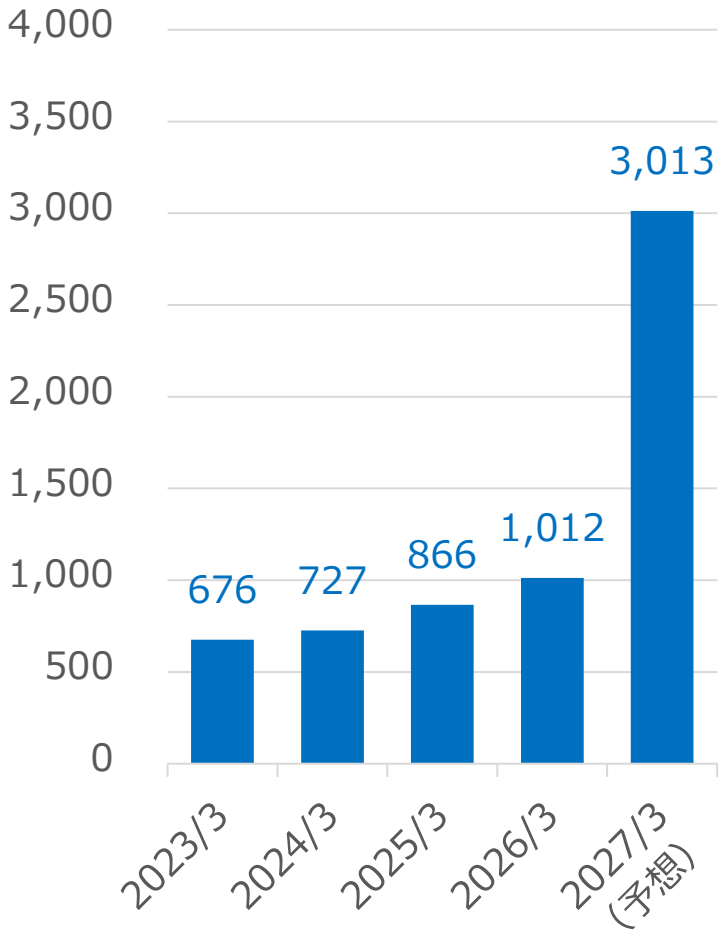
設備投資額、減価償却費及び研究開発費

(単位：百万円)

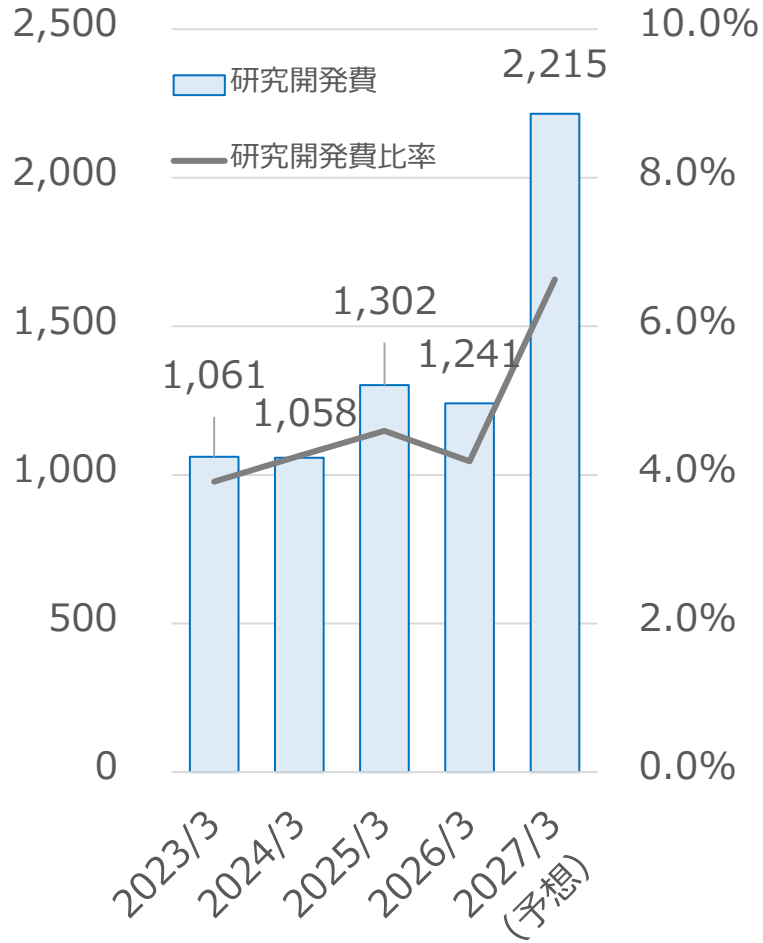
設備投資額



減価償却費



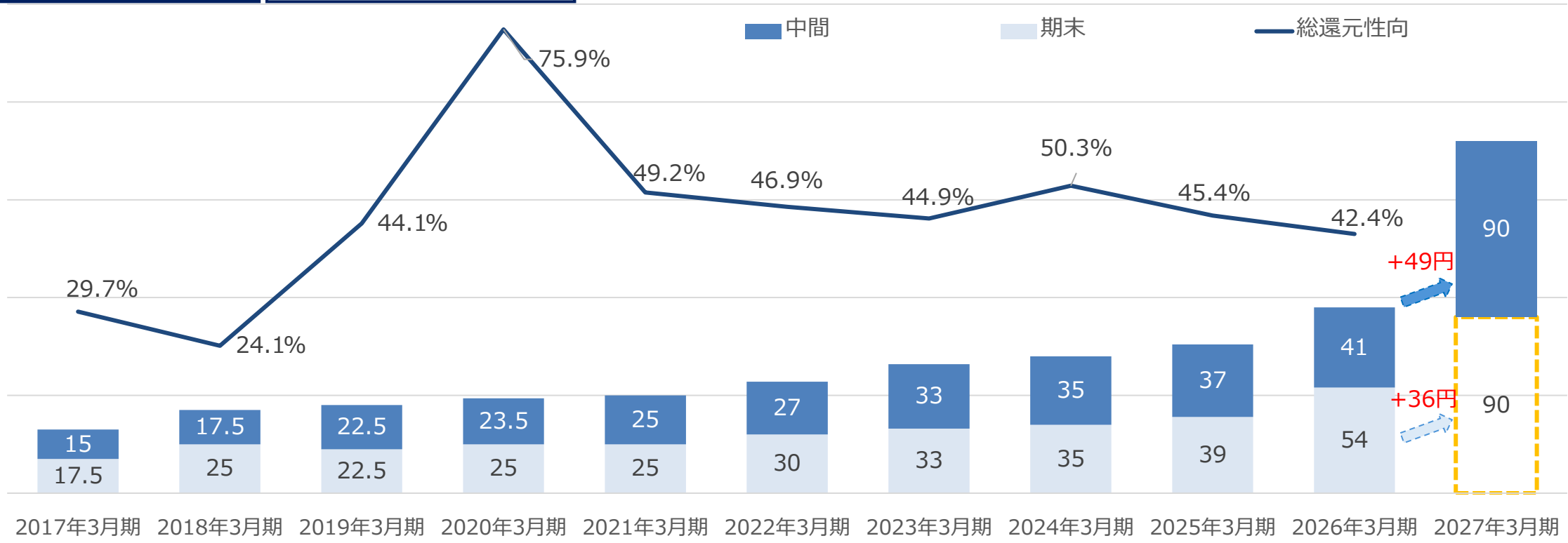
研究開発費及び
売上高研究開発費比率



2027年3月期　資本政策

1株当たりの配当金（予想）	中間配当金：90円 期末配当金：90円

17期連続増配予定



基本方針	・持続的な成長を達成するため手元流動性を確保し、安定した財務基盤を維持しつつ、成長投資を継続 ・配当は安定増配を継続 ・総還元性向を50%を目安に機動的な自己株式の取得による株主還元の実施

ESGに関する取り組み

当社グループは、ESGに配慮した課題に事業活動を通じて取り組み、
持続可能な成長を続けるグローバル企業を目指してまいります。

Environment

環境負荷低減プロセスの開発

- クロム酸フリーエッチングプロセス
- 低環境負荷化学ニッケルめっきプロセス
- 低環境負荷装飾用硫酸銅めっきプロセス
- 低環境負荷3価クロムめっき用後処理プロセス

CO_2排出量（単体）

684 t-CO_2【2026年3月期末】
※2013年度比 52.7%削減

ESG外部評価

CDP気候変動2025：B評価に認定

Social

女性管理職比率（単体）

12.5%　【2026年3月期末】

国内外拠点のISO9001取得状況

7か国12拠点　【2026年3月期末】
※日本、中国、台湾、韓国、タイ
ベトナム、メキシコ

Governance

企業統治の体制

- 取締役
  社内：6名、社外：3名（内、女性1名）
- 監査役
  常勤：1名、社外：2名（内、女性1名）

参考資料

- 会社概要
- 今後必要とされる表面処理技術
- 主な商流
- 主な製品
- 薬品用途説明 最終製品例

会社概要

創　　業	：	1957年 12月
設　　立	：	1968年 4月 1日
資 本 金	：	12億8,148万円
年　　商	：	単体 164億円　　連結 296億円　　（2026年3月期）
本社所在地	：	東京都台東区東上野 4-8-1　TIXTOWER UENO 16階
業務内容	：	表面処理薬品、表面処理装置及び関連資材の製造・販売
代表者	：	代表取締役会長兼CEO　木村 昌志 代表取締役社長兼COO　大森 晃久
従業員数	：	単体 250名　　連結 567名　　（2026年3月31日現在）

ISO認証取得

ISO9001　生産本部・本社営業部・総合研究所　JCQA-0281

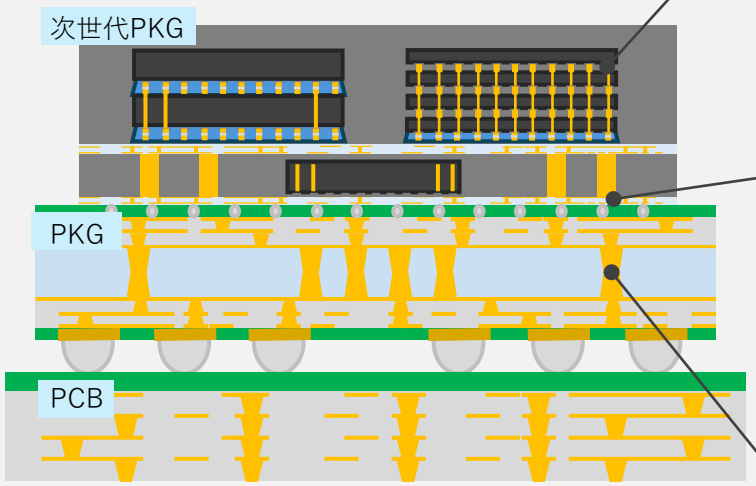
ISO14001　生産本部・総合研究所　JCQA-E-0143

今後必要とされる表面処理技術 －電子分野－

ターゲット　AIアクセラレータ、データセンタ、高機能電子デバイスなどの次世代PKG基板

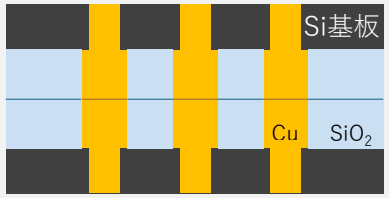
必要とされる表面処理技術

2.xD/3Dパッケージ



・高機能化に伴い多様化するパッケージ技術
・高密度実装による基板サイズの大型化
・チップ間配線距離の短縮

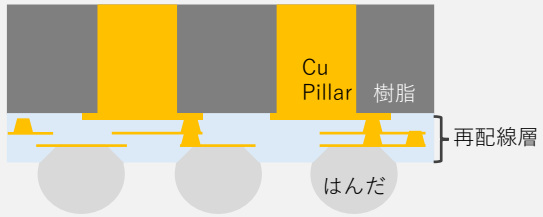
ハイブリッド接合



〇想定されるターゲット
メモリー

〇表面処理技術に要求される性能
接続信頼性の向上
優れた電気特性

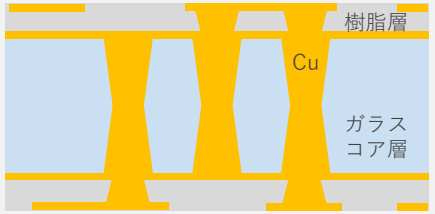
RDL（再配線）



〇想定されるターゲット
FO-WLP / PLP
RDLインターポーザ

〇表面処理技術に要求される性能
面内均一性の向上
薄膜埋まり性向上

TGV（ガラス貫通電極）



〇想定されるターゲット
ガラスコアサブストレート（FC-BGA）
ガラスインターポーザ

〇表面処理技術に要求される性能
ボイド（空隙）フリー
薄膜埋まり性向上

今後必要とされる表面処理技術 －装飾・機能分野－

必要とされる表面処理技術

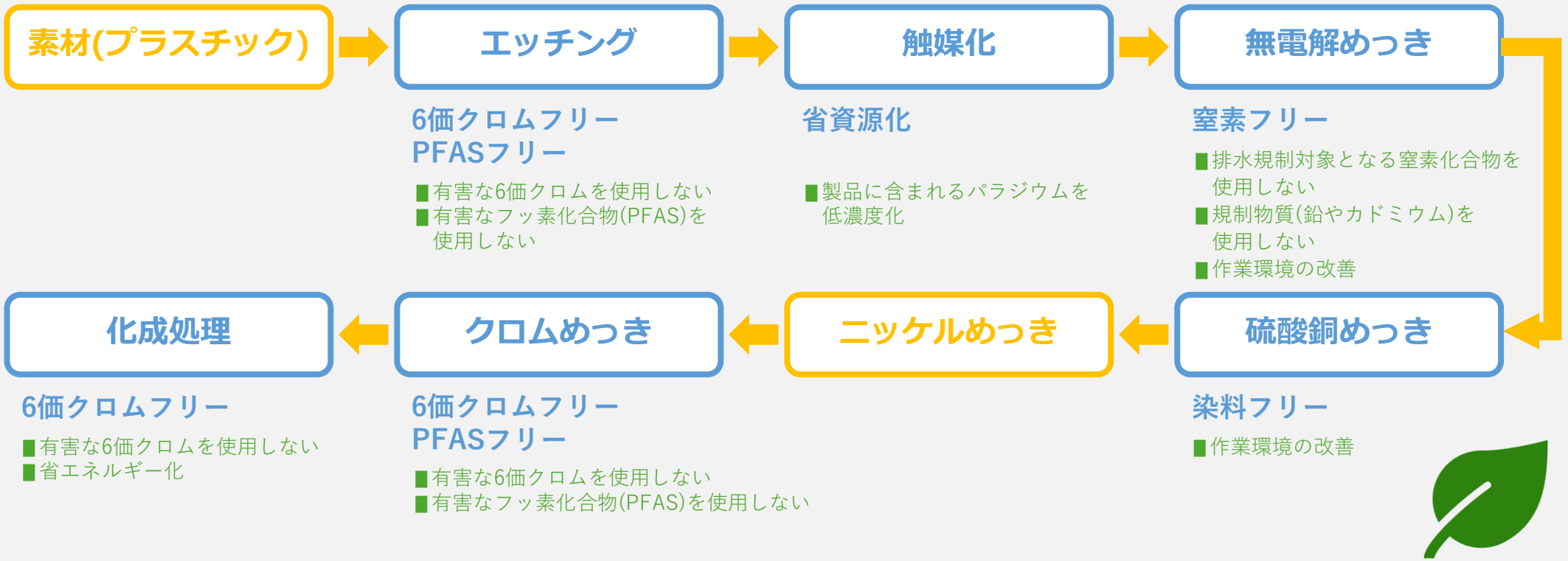
環境に配慮した表面処理技術

ターゲット

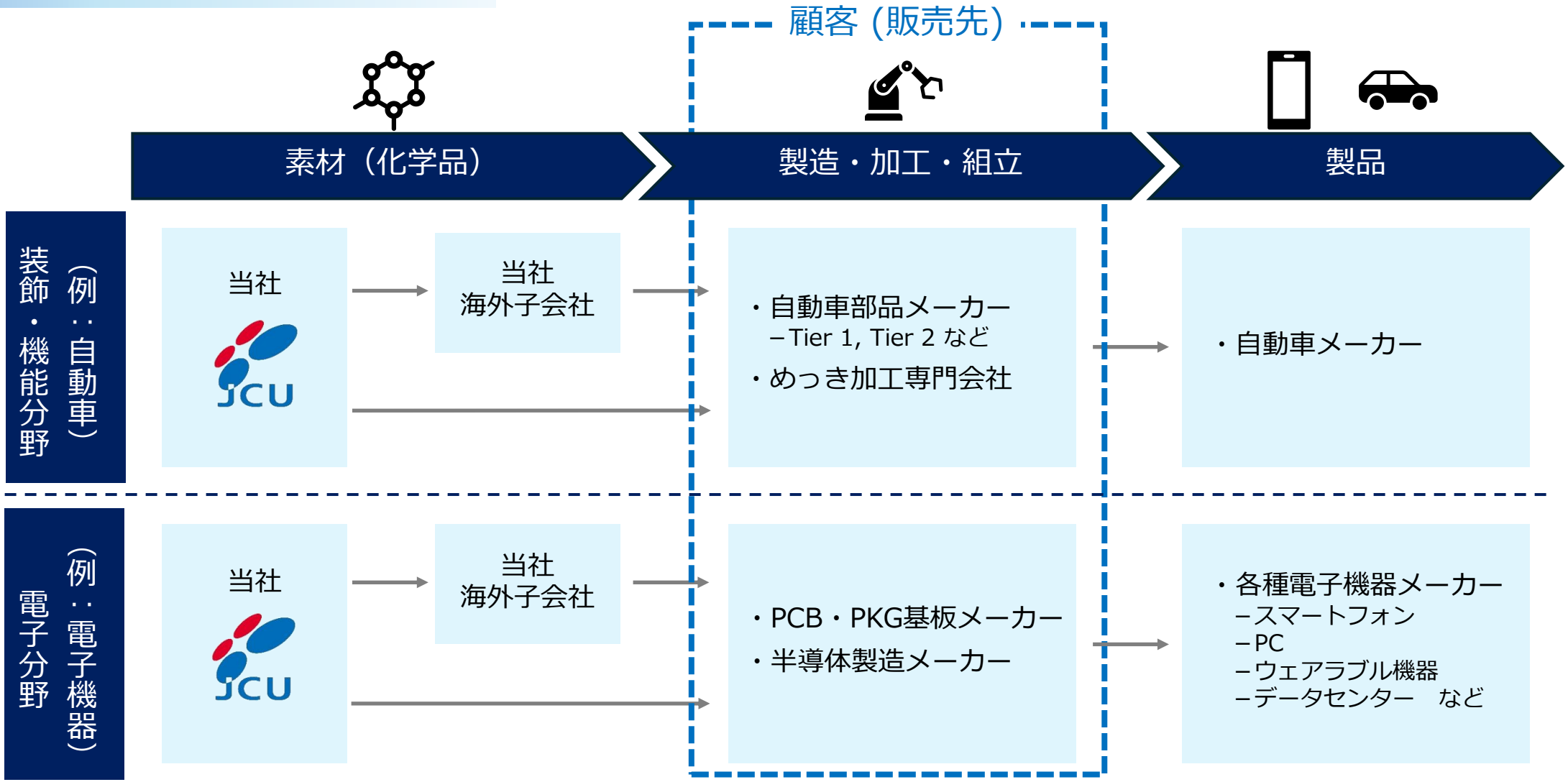
自動車部品（フロントグリル、ドアハンドル、エンブレム等）
水栓部品　（シャワーヘッド、排水栓等）

プラスチックへの装飾めっき工程

環境負荷低減プロセス



主な商流


顧客（販売先）
素材（化学品）
製造・加工・組立
製品
装飾・機能分野（例：自動車）
当社
当社
海外子会社
・自動車部品メーカー
－Tier 1, Tier 2 など
・めっき加工専門会社
・自動車メーカー
電子分野（例：電子機器）
当社
当社
海外子会社
・PCB・PKG基板メーカー
・半導体製造メーカー
・各種電子機器メーカー
－スマートフォン
－PC
－ウェアラブル機器
－データセンター　など

薬品用途説明　最終製品例

用語説明		最終製品
装飾・機能薬品	装飾・機能分野向け、金属外観の付与、サビ防止などの 機能性付与のための表面処理薬品	自動車部品、水栓金具、建築部品　など
POP薬品 (Plating on Plastics)	プラスチック上へ金属膜をめっきするための薬品 例）エッチング薬品、各種めっき薬品（銅、ニッケル、クロム）など	(自動車部品)フロントグリル、エンブレム など (水栓金具)シャワーヘッド、水栓コック など
その他基幹薬品	銅・鉄鋼などの金属素材へ金属膜をめっきするための薬品	(建築部品)ネジ、蝶番 など
電子薬品	電子信号を流すための回路、電子部品の電気接点など プリント配線板を製造するための表面処理薬品	高機能電子デバイス、データセンター等のインフラ、 通信関連部品　など
ビアフィリング薬品	プリント基板や半導体パッケージ基板などの半導体関連部品を製造する過程で層間を電気的に接続するため、ビア（孔）を銅めっきで充填する薬品	(高機能電子デバイス) スマートフォン、PC、タブレット、ゲーム機器 など (データセンター等のインフラ) 通信サーバー向けプリント基板 など (通信関連部品) 基地局、車載基板、スマート家電 など
エッチング薬品	プリント基板や半導体パッケージ基板などの半導体関連部品を製造する過程で材料の表面に形成された薄いシード層（銅）を化学反応によって剥がし、指定されたパターンの形にするための薬品	
その他電子薬品	コネクタ、リードフレーム用のめっき薬品など	
表面処理関連装置	薬品性能を最大限に引き出すための表面処理関連装置	表面処理関連装置の一例
全自動表面処理装置	素材の投入からめっきの完成まで自動運転をする装置	 プラズマ表面処理装置　 自動分析管理装置
付帯機器	表面処理装置に付随する、ろ過機等の付帯機器	
自動分析管理装置	めっき液の濃度を分析し不足分を補給して、自動で管理する装置	
プラズマ表面処理装置	プリント基板のめっき前処理用等の洗浄処理装置	

この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異なる場合があり、この資料はその実現を確約したり、保証するものではございません。

当社ホームページ:
https://www.jcu-i.com/

お問い合わせ先：経営戦略室
Email： ir2@jcu-i.com
TEL： 03-6895-7004